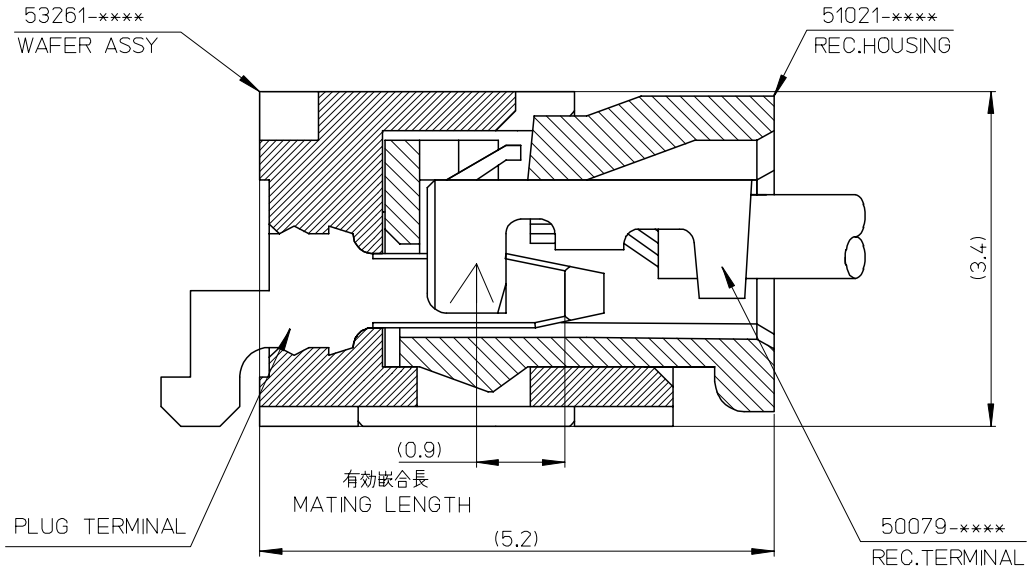


MODEL NO./MATERIAL NO.			
53261-××××	WAFER ASSY		
50079-××××	TERMINAL	REC.	
51021-××××	HOUSING		

RELEASED
EC NO: J2006-2426
DRWN:YAOYAGI 2006/02/02
CHKD:YMAEDA 2006/02/03
APPR:NUKITA 2006/02/07

REV	DESCRIPTION
0	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±---
10 OVER 30 UNDER	±---
30 OVER	±---
ANGULAR	±--- °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	SCALE	DESIGN UNITS	
MM ONLY	---	METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY	DATE
Y.AOYAGI	2006/01/30
CHECKED BY	DATE
Y.MAEDA	2006/01/30
APPROVED BY	DATE
N.UKITA	2006/01/30

TITLE
1.25 W-TO-B CONN.
51021,53261
MATING CROSS SECTION

molex MOLEX INCORPORATED

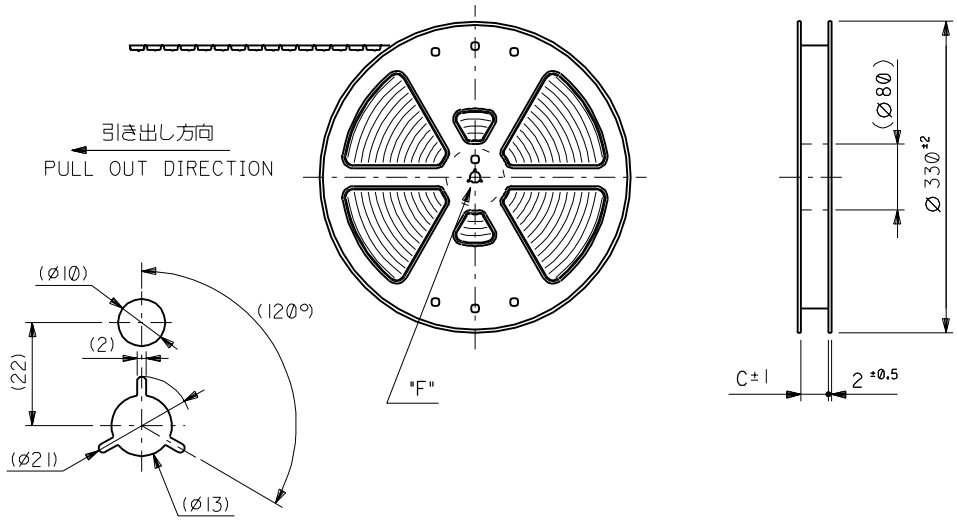
MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
SEE CHART	SD-51021-002	1 OF 1

SIZE A3

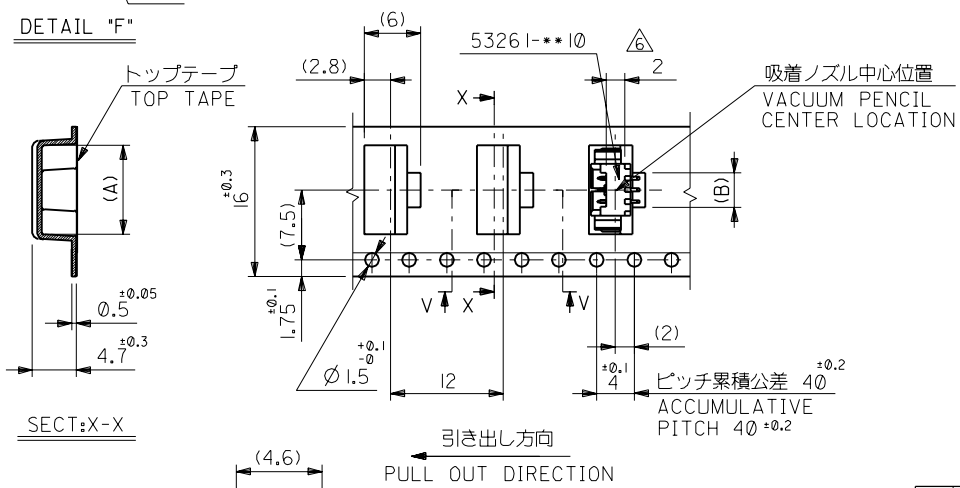
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DWG. NO. SD-53261-**90

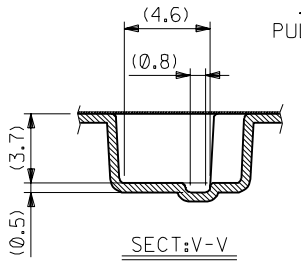
:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



DETAIL "F"



SECT:X-X



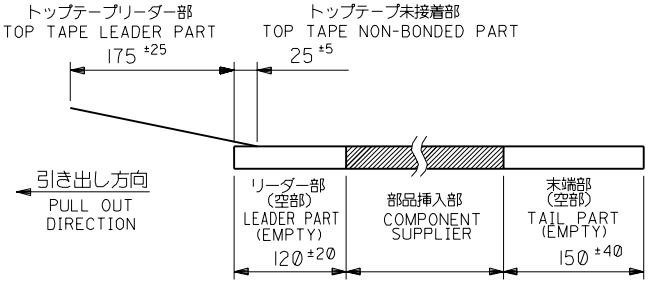
SECT:V-V

16mm幅キャリアテープ

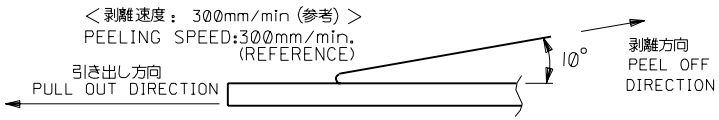
16mm WIDTH CARRIER TAPE

注記 NOTES

1. 53261-**10 の詳細寸法については図面 SD-53261-**10 を参照下さい。
   RE DETAILED DIMENSIONS,SEE SD-53261-**10.
2. 梱包数量：1000個／リール
   NUMBER OF CONNECTOR:1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



4. トップテープの剥離強度：0.1N～0.59N(10.2～60gf)（剥離方向は下図参照）
   PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1N～0.59N(10.2～60gf)
   (PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)



5. 材料 (MATERIAL)
   キャリアテープ(CARRIER TAPE):ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
   トップテープ (TOP TAPE): PET ,PE ,PEF
   リール (REEL):ポリスチレン（PS）<リサイクル材含む>
   POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

6 コネクタ、ハウジング平面部
CONNECTOR, HOUSING FLAT AREA

キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.
16	16.4	3.7	9.5	53261-0390	3
		2.45	8.25	53261-0290	2

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	±0.3				
10以上 OVER 30未満 UNDER	±0.25	F	変更 REVISED (JC2001-0437)	S.M T.Y	'00/12/8
10未満 UNDER	±0.2	E	変更及び再作図 REVISED&REDRAWN (J30522)	K.T H.H	'93/6/1
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL 注記参照 SEE NOTES

仕上げ FINISH —〃—

適用電線範囲 WIRE RANGE —〃—

被覆外径 INS. RANGE —〃—

DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO

CHK'D BY '00/12/8 T.YAMAGUCHI

APP'D BY '00/12/8 M.FUKUSHIMA

尺度 SCALE —〃—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.25 WIRE TO BOARD CONN.
WAFER ASS'Y FOR SMT.
EMBOSSED TAPE PACKAGE

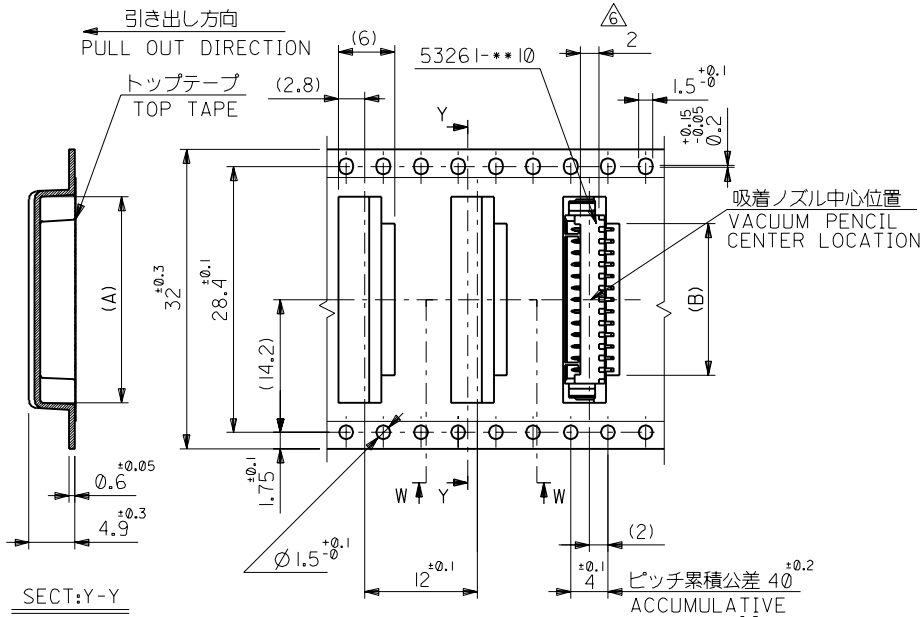
DWG. NO. SD-53261-**90 SHEET 1 OF 3 REV F

53261.S10

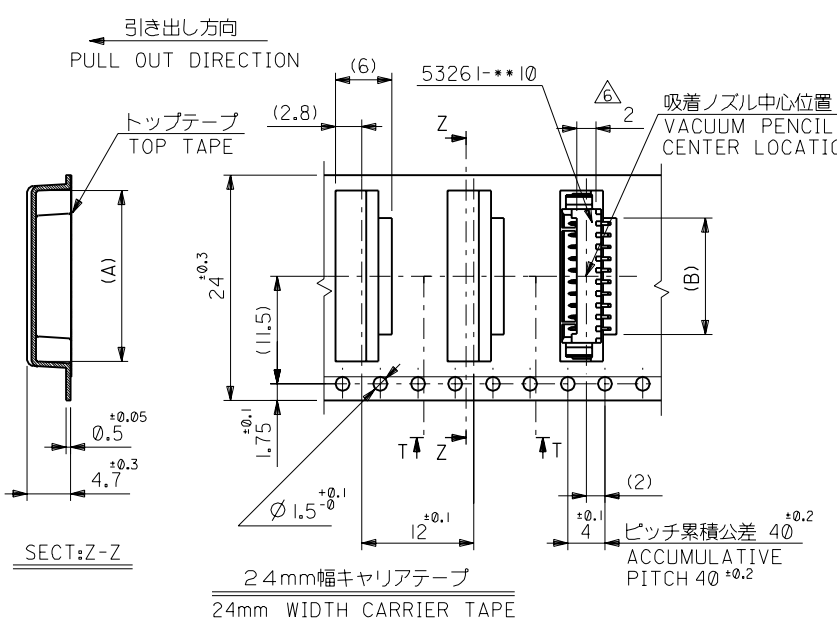
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

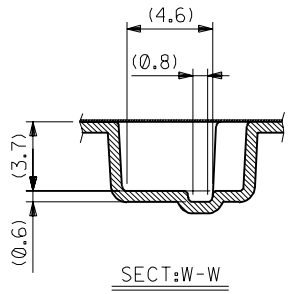
DWG. NO. SD-53261-**90

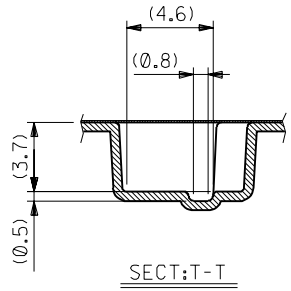


32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE



24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE





キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.
32	32.4	16.2	22	53261-1390	13
		14.95	20.75	-1290	12
		13.7	19.5	-1190	11
24	24.4	12.45	18.25	-1090	10
		11.2	17	-0990	9
		9.95	15.75	-0890	8
		8.7	14.5	-0790	7
		7.45	13.25	-0690	6
		6.2	12	-0590	5
		4.95	10.75	53261-0490	4

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE
F	変更 REVISED (IR2000-0471)	S.M / T.Y	'00/12/8
E	変更及び再作図 REVISED&REDRAWN (J30522)	K.T / H.H	'93/6/1

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	//
適用電線範囲 WIRE RANGE	//
被覆外径 INS. RANGE	//
DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO	CHK'D BY '00/12/8 T.YAMAGUCHI
APP'D BY '00/12/8 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE //

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR SMT. EMBOSSED TAPE PACKAGE

DWG. NO. SD-53261-**90 SHEET 2 OF 3 REV F

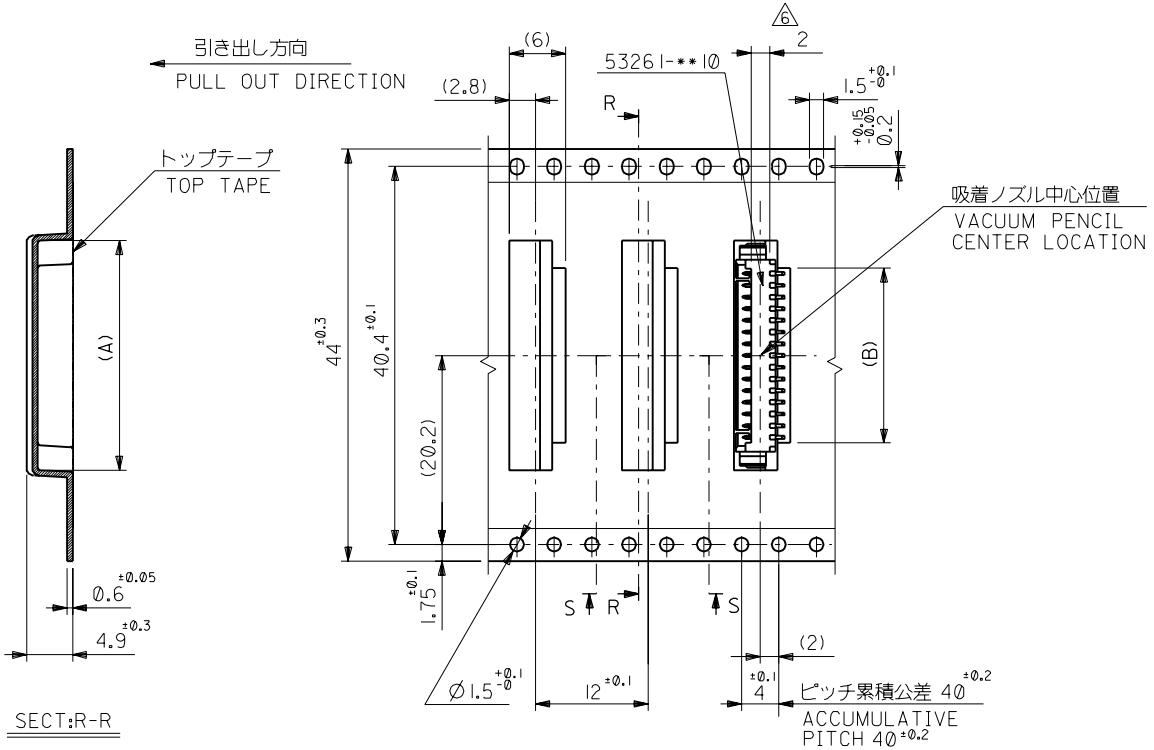
:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

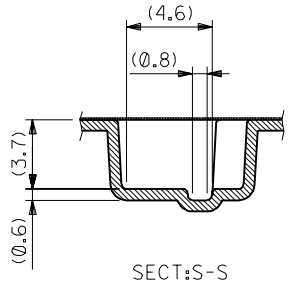
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(Ø32)MXJ-32

53261S11

DWG. NO. SD-53261-**90





44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

44	44.4	18.7	24.5	53261-1590	15
		17.45	23.25	53261-1490	14
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	±3°					
30 以上 OVER	±0.3					
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	F	変更 REVISED (JC2001-0437)	S.M / T.Y	'00/12/8	
10 未満 UNDER	±0.2	E	変更及び再作図 REVISED&REDRAWN (J30522)	K.T / H.H	'93/6/1	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. / CHK.	日付 DATE	

材料 MATERIAL 注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH //
適用電線範囲 WIRE RANGE //
被覆外径 INS. RANGE //
DRAWN BY '93/6/1 K.TOJO
CHK'D BY '00/12/8 T.YAMAGUCHI
APP'D BY '00/12/8 M.FUKUSHIMA
尺度 SCALE //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.25 WIRE TO BOARD CONN.
WAFER ASS'Y FOR SMT.
EMBOSSED TAPE PACKAGE

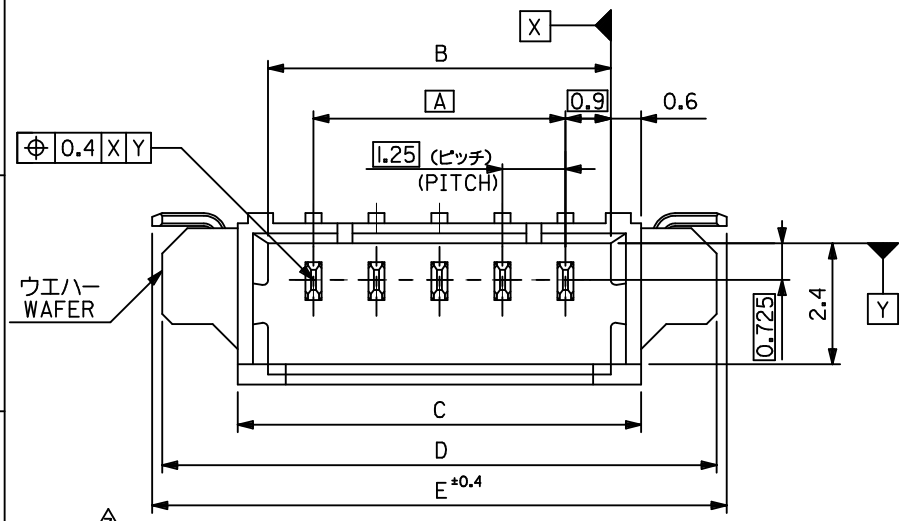
DWG. NO. SD-53261-**90 SHEET 3 OF 3 REV F

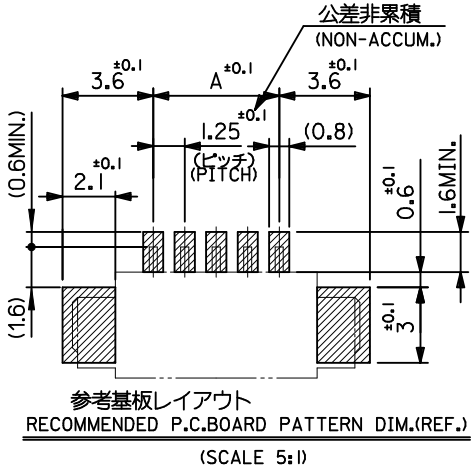
:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-0IC(032)MXJ-32

5326 1.S 4

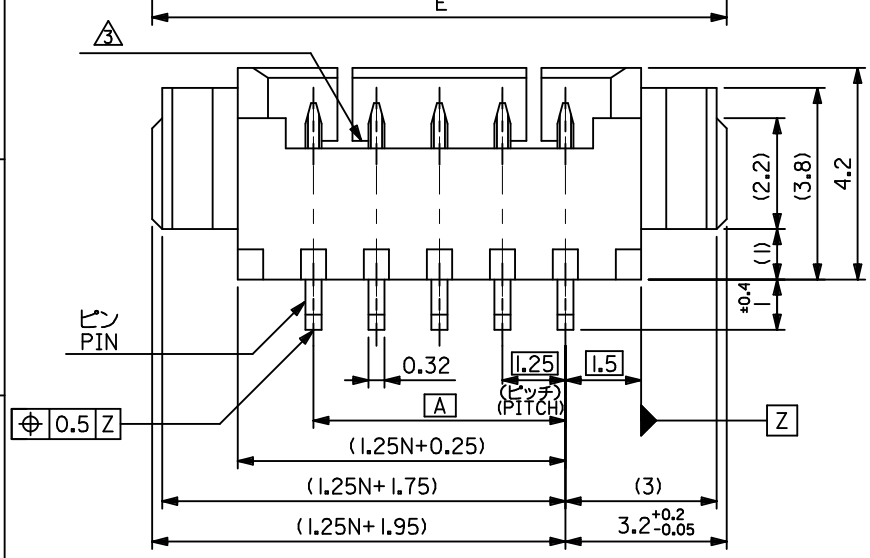


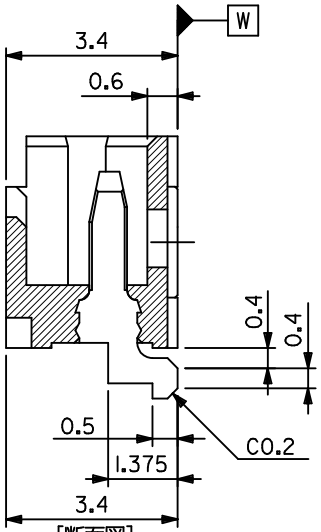


参考基板レイアウト
RECOMMENDED P.C.BOARD PATTERN DIM.(REF.)
(SCALE 5:1)

注記 NOTES

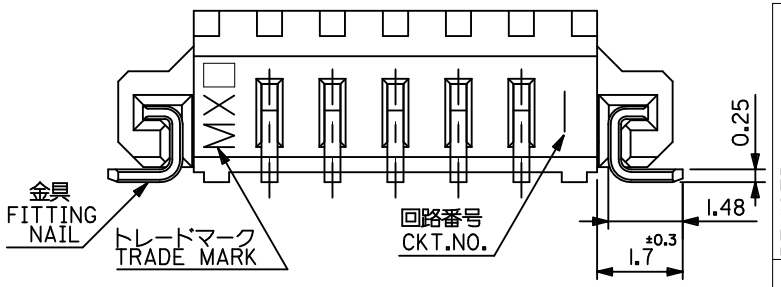
1. 嵌合相手： 51021シリーズ
   MATES WITH: 51021 SERIES
2. 材質 MATERIAL
   ウエハー ：NYLON46,UL94V-0
   ピン ：リン青銅、半田メッキ
   PIN : PHOS-BRO., Sn-Pb(9:1) 3μmMIN. OVER Cu 1μmMIN. PLATING
   金具 ：リン青銅、半田メッキ
   FITTING NAIL : PHOS-BRO., Sn-Pb(9:1) 2μmMIN. OVER Cu 1μmMIN. PLATING
3. ロック窓は2、3極は1箇所、4極以上は2箇所とする。
   LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKT. AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CKT.
4. ソルダーテール部のズレ量及び金具（補強板）のズレ量は基準面 W に対し、上方向 0.05 MAX.、下方向に 0.1 MAX. とする。
   OFFSET BETWEEN BASIS PLANE W TO SOLDER TAIL BOTTOM AND FITTING NAIL BOTTOM : UPPER SIDE : 0.05MAX. LOWER SIDE : 0.1MAX.





[断面図]
[CROSS SECTION]

E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.
23.9	23.5	20.5	19.3	17.5	53261-1510	15
22.65	22.25	19.25	18.05	16.25	-1410	14
21.4	21	18	16.8	15	-1310	13
20.15	19.75	16.75	15.55	13.75	-1210	12
18.9	18.5	15.5	14.3	12.5	-1110	11
17.65	17.25	14.25	13.05	11.25	-1010	10
16.4	16	13	11.8	10	-0910	9
15.15	14.75	11.75	10.55	8.75	-0810	8
13.9	13.5	10.5	9.3	7.5	-0710	7
12.65	12.25	9.25	8.05	6.25	-0610	6
11.4	11	8	6.8	5	-0510	5
10.15	9.75	6.75	5.55	3.75	-0410	4
8.9	8.5	5.5	4.3	2.5	-0310	3
7.65	7.25	4.25	3.05	1.25	53261-0210	2



REVISED
EC NO: J2012-1315 2012/04/17
DRWN:NITO 2012/04/17
CH'KD:KASAKAWA 2012/04/17
APPR:YOITO 2012/04/26
DESCRIPTION
REV H

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	MM ONLY
SCALE	10:1
DESIGN UNITS	METRIC
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY / DATE	NITO 2012/04/17
CHECKED BY / DATE	KASAKAWA 2012/04/17
APPROVED BY / DATE	YOITO 2012/04/26
MATERIAL NO.	SEE DRAWING
DOCUMENT NO.	SD-53261-054
SHEET NO.	1 OF 1
SIZE	A3

TITLE: 1.25 WIRE TO BOARD WAFER ASS FOR SMT RIGHT ANGLE

molex

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION